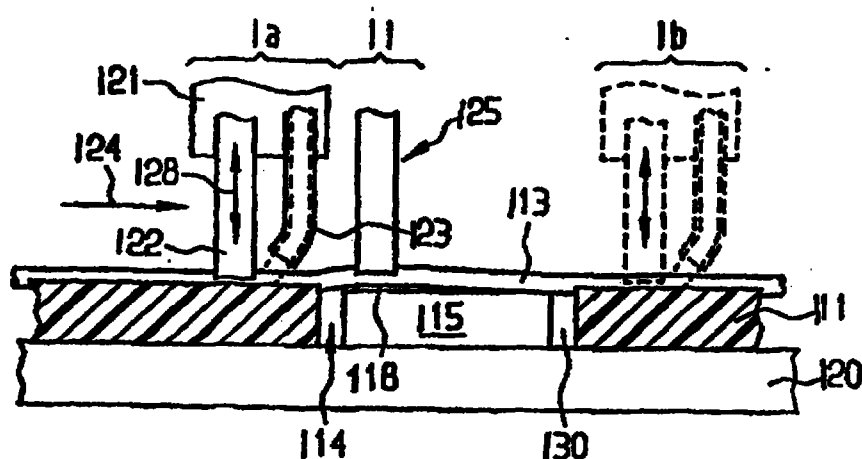


**PCT**WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : G06K 19/077	A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/30418 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 21. August 1997 (21.08.97)								
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE97/00261</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 12. Februar 1997 (12.02.97)</p> <p>(30) Prioritätsdaten:</p> <table border="0"> <tr> <td>196 04 840.0</td> <td>12. Februar 1996 (12.02.96)</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>196 19 771.6</td> <td>17. Mai 1996 (17.05.96)</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>196 20 242.6</td> <td>20. Mai 1996 (20.05.96)</td> <td>DE</td> </tr> </table> <p>(71)(72) Anmelder und Erfinder: FINN, David [IE/DE]; König-Ludwig-Weg 24, D-87459 Pfronten (DE). RIETZLER, Manfred [DE/DE]; Am Alsterberg 10, D-87616 Marktoberdorf (DE).</p> <p>(74) Anwalt: TAPPE, Hartmut; Jaeger, Böck & Köster, Egloffsteinstrasse 7, D-97072 Würzburg (DE).</p>	196 04 840.0	12. Februar 1996 (12.02.96)	DE	196 19 771.6	17. Mai 1996 (17.05.96)	DE	196 20 242.6	20. Mai 1996 (20.05.96)	DE	<p>(81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, CN, JP, KR, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i></p>
196 04 840.0	12. Februar 1996 (12.02.96)	DE								
196 19 771.6	17. Mai 1996 (17.05.96)	DE								
196 20 242.6	20. Mai 1996 (20.05.96)	DE								

(54) Title: **METHOD AND DEVICE FOR BONDING A WIRE CONDUCTOR**(54) Bezeichnung: **VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KONTAKTIERUNG EINES DRAHTLEITERS**

(57) Abstract

The invention relates to a method and device for bonding a wire conductor (13) when producing a transponder unit having a wire-wound coil (12) and a chip unit (15) and arranged on a substrate (11). During a first phase the wire conductor (13) extends across the bonding pad (18, 19) or a region receiving the bonding pad, and is fixed to the substrate (11) in relation to the bonding pad (18, 19) or the region associated with the bonding pad, and during a second phase the wire connector (13) is connected to the bonding pad (18, 19) by connection means (25, 37).

(57) Zusammenfassung

Verfahren und Vorrichtung zur Kontaktierung eines Drahtleiters (13) bei der Herstellung einer auf einem Substrat (11) angeordneten, eine Drahtspule (12) und eine Chipseinheit (15) aufweisenden Transpondereinheit, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter (13) über die Anschlußfläche (18, 19) oder einen die Anschlußfläche aufnehmenden Bereich hinweggeführt und relativ zur Anschlußfläche (18, 19) bzw. dem der Anschlußfläche zugeordneten Bereich auf dem Substrat (11) fixiert wird, und in einer zweiten Phase die Verbindung des Drahtleiters (13) mit der Anschlußfläche (18, 19) mittels einer Verbindungseinrichtung (25, 37) erfolgt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		